



2025年10月1日

各位

会 社 名 テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 八 木 毅 之
(コード番号：6028 東証プライム市場)
問 合 せ 先 経営企画部広報 IR 室長 小 林 徹
(TEL. 03-6385-7998)

社債の早期償還の検討状況に関するお知らせ

当社が2025年9月25日に公表した「ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果、並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2025年8月7日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及びThe Bank of New York Mellon（以下「本預託銀行」といいます。）に預託された当社株式を表章するものとして本預託銀行により米国で発行されている米国預託株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立したことを踏まえ、当社は、2021年10月26日に発行したテクノプロ・ホールディングス株式会社第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（以下「本社債」といいます。）の方針について検討しております。

公開買付者によれば、公開買付者は、本公開買付け及びその後の一連の手続（公開買付者の要請により当社が実施する予定の、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づく当社株式の併合を含みます。）により、当社を公開買付者の完全子会社とすることを予定しており、その場合、当社株式が上場廃止となることに鑑み、当社は、償還期限変更のための社債権者集会を開催し、本社債を早期償還することを検討しております。現時点では、社債権者集会での決議及び裁判所からの許可を経て、2025年12月31日までの償還を想定しております。

今後の具体的な日程及び償還条件並びに社債権者集会の詳細等につきましては、公開買付者と協議の上、決定次第速やかにお知らせいたします。

以 上